

2018年8月27日

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7-20

ディーアイシービル

D I C 3Dプリンタ向け光造形用コンパウンドの研究開発を本格化

工業用分野や歯科分野などで高精度な造形を実現

D I C株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：猪野薫）は、3Dプリンタ向けの成形材料として光造形用コンパウンドの研究開発を本格的に開始しました。当社は、独自のポリマ設計技術とコンパウンド技術を結集し開発を行うことで、工業分野での製品製造や歯科分野での機器製造など、強靱性と造形精度に優れた材料のラインナップを進めていきます。

3Dプリンタは、航空宇宙産業や自動車、メディカルなど多様な分野で用途展開が進んでおり、欧米を中心にグローバル市場は年率20%を超える勢いで続伸しています。中でも、光照射により成形材料を積層して造形する光造形方式は、射出成型では不可能な複雑形状の樹脂（プラスチック）造形が可能なることに加えて、最近の高速造形できる3Dプリンタ機器の登場により、工業用部品の製造手段として注目度が高まっています。

当社は、長年にわたって安定基盤事業である印刷インキやポリマにより培った独自の分散・高分子設計の基盤技術を多数有しています。また、当社が過去から蓄積した複合材料に関する設計・配合技術を組み合わせることで、3Dプリンタ分野において近年急成長を続ける液槽光重合方式（DLPタイプ、SLAタイプ）に向けた材料開発を進めています。

同研究開発は日本のほかに、多種多様な3Dプリンタ関連企業が存在する韓国において2018年より本格稼働を開始した「ファインケミカル技術センター 韓国」にも研究部署を併設し、両国間で連携して行っています。

当社グループでは、今後も次世代事業の創出を目指し、グローバルな社会要請にマッチした最適ビジネスモデルの構築を目指します。

以上